

プロジェクション・モアレ式
高精度 反り・変形測定システム

TDM[®] >>> LARGE SCALE

高精度

- ◆ 反り (Z) 分解能
最小 1 μ m ~
- ◆ 空間分解能 (X,Y)
最小 15 μ m ~
- ◆ 被写界深度
~ 25mm

※計測する視野による

高機能

- ◆ CTE 計測 (オプション)
反りと同時計測可能
- ◆ 強力ヒーター搭載
上下のヒーターを
独立して制御可能

広視野

- ◆ 測定可能エリア
400mm \times 400mm
- ◆ 大型サンプルの計測
ウエハーや大型の
ボードも計測可能



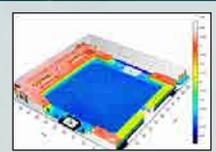
幅広いアプリケーションに対応

- ◆ 部品特性評価：
高速劣化試験プロファイル、ON/OFF サイクル等
- ◆ リフロープロファイルとの互換性のための部品認定
- ◆ 部品硬化プロセスの最適化
- ◆ JEITA-ED-7306 IPC-9641 / JEDEC 22B112A に
準じた部品及び PCB の認定

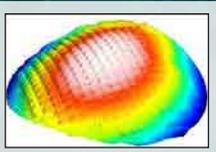
特長・優位点

- ◆ 上下独立してコントロール可能なヒーターを使用し、
優れた温度均一性を実現
- ◆ 高速加熱冷却ヒーター
- ◆ 微細解析のための超高解像度カメラ
- ◆ サンプルの出し入れが簡単なサンプルホルダー

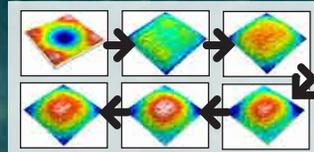
計測例
Application



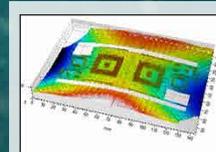
ソケット



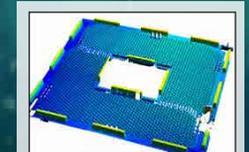
ウエハーレベルCSP



BGAリフロー



プリント回路基板



複合基板